

Laser PCB 가공기 | ProtoLaser ST

| 제품 특징 |

- 복잡한 디지털 및 아날로그 회로, RF 및 마이크로파 회로 기판등 공구 마모 없이 레이저 시스템은 까다로운 재료도 처리하며 단면 또는 양면 적층 재료의 구조화에 이상적으로 적합함.
- 모든 일반적인 회로 기판 재료에 대한 빠른 표면 처리
- 비접촉식 스캐너 기반 프로세스를 통한 정확한 형상
- 컴팩트한 탁상용 시스템으로 안전하고 모든 실험실에 사용 가능(레이저 1등급)
- 지능적이고 직관적인 시스템 소프트웨어 사용



제품 규격

최대 레이아웃 영역 (X/Y/Z)	229mm x 305mm x 7mm(9" x 12" x 0,28")
레이저 파장	1064nm
최대 레이저 출력	16W
레이저 펄스 주파수	25-400kHz
레이저 빔의 직경	20 ± 2 μm(0,78 ± 0,08 Mil)
구조화 속도	적층 기판 18 μm(0,5 oz) Cu, 8,5 cm ² /min(1,3 in ² /min)
최소 라인/공간	FR4 18μm(0,5oz) Cu에서 100μm / 50μm(3,9mil / 2mil)
스캔 필드의 위치 정확도	± 10μm(±0,39mil)
스캔 필드의 반복성	± 1,8μm(±0,07mil)
Dimensions (W x H x D)	725 mm x 665 mm x 840 mm (28,6" x 26,2" x 33,1")
Weight	115 kg (254 lbs)
Power supply	115-230 V, 50-60 Hz, 500 W
Compressed air supply	Min, 6 bar; 20 l/min (min, 87 PSI; 20 l/min)
Software	LPKF CircuitPro Basic
Options and accessories	Dust extraction unit, compressor, starter set

